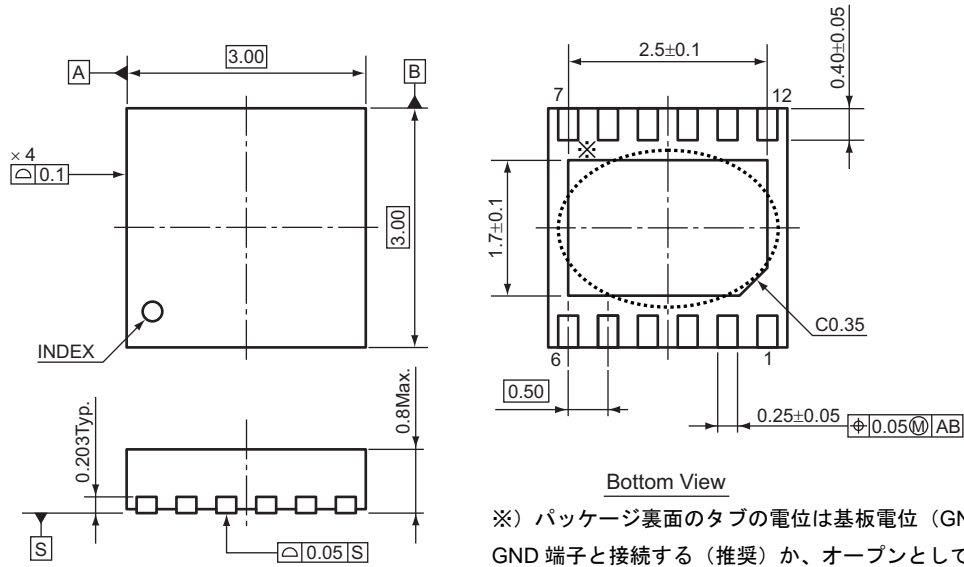


DFN3030-12

(単位 : mm)

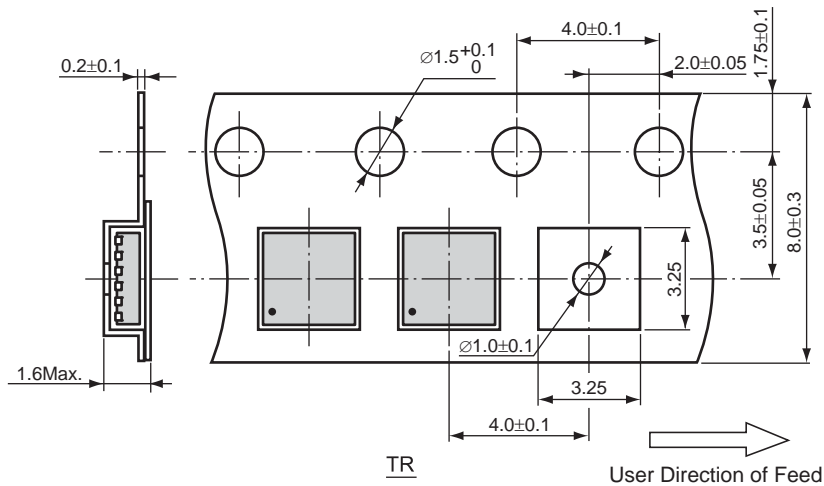
■ パッケージ外形図



Bottom View

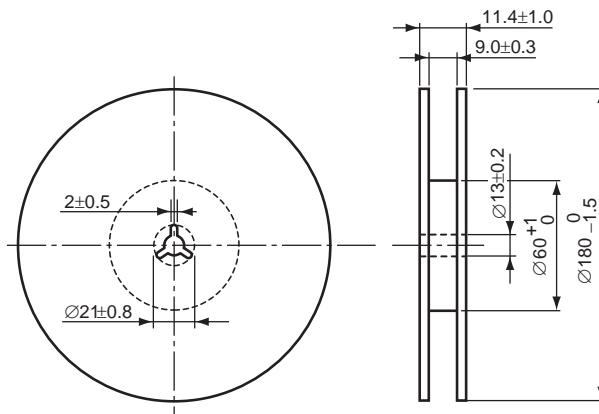
※) パッケージ裏面のタブの電位は基板電位 (GND) です。GND 端子と接続する (推奨) か、オープンとしてください。

■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=3,000 個)



## ■ 許容損失について (DFN3030-12)

DFN3030-12パッケージの許容損失について特性例を示します。

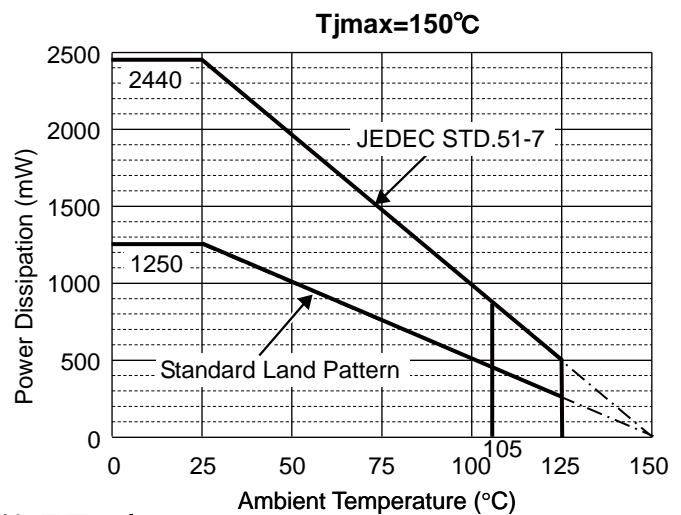
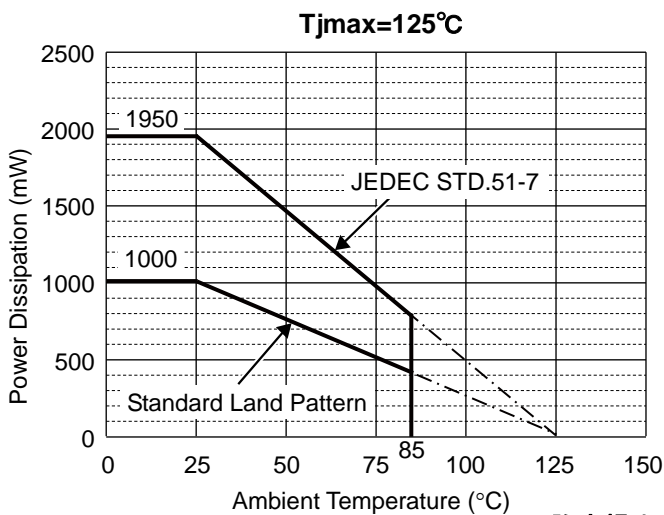
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

|        | 標準実装条件              | JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件                               |
|--------|---------------------|--|
| 測定状態   | 基板実装状態 (風速 0m/s)    | 基板実装状態 (風速 0m/s)                                     |
| 基板材質   | ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)    | ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)                                     |
| 基板サイズ  | 40mm × 40mm × 1.6mm | 76.2mm × 114.3mm × 1.6mm                             |
| 配線率    | 表面 約 50%、裏面 約 50%   | 表裏層 :60mm 角 :配線率 10%以下<br>内層 :74.2mm 角 :配線率 100%     |
| スルーホール | 直径 0.54mm × 32 個    | 直径 0.85mm × 64 個<br>※タブと内層及び裏面とを<br>0.3mm のスルーホールで接続 |

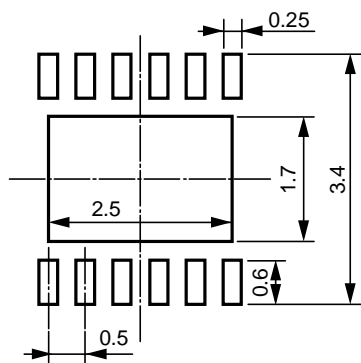
測定結果 (Ta=25°C)

|      | 標準実装条件  | JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件  |
|------|---|---|
| 許容損失 | 1000mW (Tjmax=125°C)<br>1250mW (Tjmax=150°C)                              | 1950mW (Tjmax=125°C)<br>2440mW (Tjmax=150°C)                                |
| 熱抵抗値 | $\theta_{ja}=100^{\circ}\text{C/W}$<br>$\theta_{jc}=18^{\circ}\text{C/W}$ | $\theta_{ja}=51.2^{\circ}\text{C/W}$<br>$\theta_{jc}=5.9^{\circ}\text{C/W}$ |

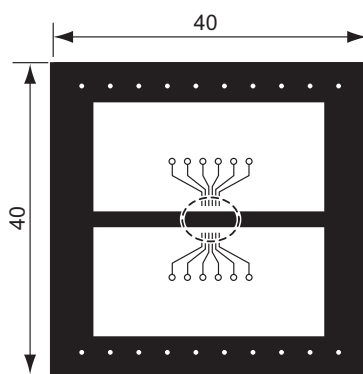


許容損失 対 周囲温度

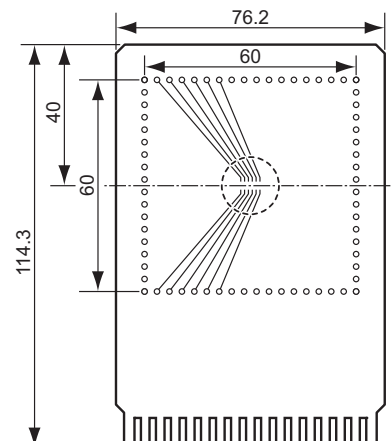
## ■ 基板パッド推奨寸法



(単位 : mm)



標準



JEDEC STD.51-7 準拠

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

測定用基板レイアウト